



## 致股東報告書

各位股東、各位女士、先生大家好：

本人謹代表董事會及全體員工感謝諸位股東對本公司之支持與愛護。同時敬向諸位股東報告，本公司民國一一二年度經營成果及民國一一三年度經營計劃。

### 一、民國一一二年度營業報告

#### (一)民國一一二年度營業計劃實施成果

本公司一一二年度合併營業收入淨額為新台幣 10,759,092 千元，較一一一年度 11,897,939 千元減少 9.57%；稅前淨利為新台幣 880,959 千元，較一一一年度 933,376 千元減少 5.6%；稅後淨利為新台幣 605,776 千元及每股盈餘 7.02 元，與前一年度稅後淨利為新台幣 613,158 千元及每股盈餘 7.1 元相較，微幅下降 1.2%。因後疫情時代全球經濟環境、國際貿易活動及產業鏈重組等因素交互影響下，整體經濟復甦情況尚未明朗，經營及獲利上都一再面臨挑戰。

現今散熱產品應用範圍相當廣泛並日益增加，並普及於 PC、NB、智慧型手機、雲端資料中心、汽車及人工智慧(AI)等領域，整體散熱產品需求與市場規模皆持續擴大應用並雨露均霑。本公司持續強化深耕已久之合作夥伴及客戶關係，並開發車用散熱、雲端資料中心散熱、高瓦特數氣冷散熱以及液冷散熱等產品應用以滿足新客戶及市場需求。並佈局 EV、AI、IoT 及 5G 等相關應用所帶動的產品發展為目標，全面提升全球重點區域及客戶之連結。因受惠於伺服器、網通市場需求穩健成長，並看好明年筆電的汰換週期將產生的換機商機，相關產品營收業績仍有望向上提升。隨著伺服器及網通等市場需求愈大，相關零組件的需求亦增加，而散熱產品則是提高效率的關鍵之一。在現今全球 AI 新浪潮帶動運算力升級之下，整體相關產業可望擴展更多商機。

本公司研發團隊多年來戮力並專注於散熱產品應用之研究與開發，使產品能更輕薄、性能更提升；也著力於非銅合金技術研發，目標運用於條件更嚴苛的車用與電力電子散熱等方案。公司每年投入於研究發展之費用佔整體營收均超過 4%，近兩年更達到 5% 以上。時時保持動力且不斷努力於開發新產品，將與時俱進之研發成果與客戶產品連結並應用，以期達到雙贏效果。例如：近期已完成 3DVC 產品相關信賴度開發測試等。另，以「前瞻晶片熱管理創新暨生產技術研發中心計畫」參與經濟部技術司 A+ 企業創新研發淬鍊計畫並取得研發專案補助，研發之專案亦獲政府肯定。

(二)預算執行情形：依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司未公開民國一一二年度財務預測資訊，無需揭露一一二年度預算執行分析資料。

### (三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元

| 項目   | 年度              | 111 年度    | 112 年度     |
|------|-----------------|-----------|------------|
|      | 財務收支            | 營業收入      | 11,897,939 |
| 營業毛利 |                 | 2,176,310 | 2,106,327  |
| 稅後淨利 |                 | 613,158   | 605,776    |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%)        | 5.68      | 5.82       |
|      | 權益報酬率(%)        | 12.23     | 10.92      |
|      | 稅前淨利佔實收資本額比率(%) | 108.10    | 102.02     |
|      | 純益率(%)          | 5.15      | 5.63       |
|      | 基本每股盈餘(元)       | 7.10      | 7.02       |

### (四)研究發展狀況

#### 1. 最近二年度研究發展支出

單位：新台幣千元

| 年 度          | 111 年度  | 112 年度  |
|--------------|---------|---------|
| 研究發展費用金額     | 574,543 | 591,822 |
| 佔當年度營收比率 (%) | 4.80    | 5.50    |

#### 2. 研究發展成果

##### (1)開發成功之技術或產品

- (i) 智慧手機散熱產品--0.3mm 以下超薄均溫板開發完成。
- (ii) 高密度運算伺服器散熱產品--300 瓦以上氣冷散熱模組開發完成。
- (iii) 網通設備散熱產品--600 瓦以上氣冷散熱模組開發完成。
- (iv) 車載 IGBT 散熱產品--2k 瓦以上液冷模組開發完成。

##### (2)進行開發之技術或產品

- (i) 持續 3S 輕/薄/強(Slight/Slim/Strong)散傳熱產品研發。
- (ii) AI 晶片散熱產品--100 W/cm<sup>2</sup> ~ 200W/cm<sup>2</sup> 高熱通量熱傳元件開發。
- (iii) 第三代半導體散熱產品--耐-40°C ~ 260°C 極高極低溫熱傳元件開發。
- (iv) 元宇宙穿戴式散熱產品--輕薄型非銅合金熱傳元件開發。
- (v) 3DVC 700-1250W 開發
- (vi) 暫態計算開發

## 二、民國一一三年度營業計劃概要

### (一)經營方針

1. 持續開發新的產業及領域、新的合作客戶，並超前部屬掌握契機以利擴大營收規模。不斷深化與合作夥伴之關係，精進服務對策。
2. 持續延攬精良之研發人員，強化研發部門組織，提升產品開發效率及品質。另，不斷研發新型產品及技術，以厚實未來競爭之利基。
3. 運用 Nidec 整體集團資源，強化業務、產品開發、品質管理、採購等功能，不斷加大集團全球競爭力，以厚植深遠的實力。
4. 投注發展越南工廠，越南廠已達一定生產規模，並通過多家客戶之認證，未來將發揮高度的產能利用率，成為堅實的生產基地之一。
5. 臺灣工廠將專注于研發並產製新機種，量產機種則移向越南及中國生產。

### (二)預計銷售數量及其依據

本公司主要銷售產品為熱管、熱板相關散熱模組及散熱片；主要產品線應用以個人電腦產業(PC)、伺服器(Server)、網路通信、智慧型手機及遊戲機等為主。本公司民國一一三年度除了穩固 PC、伺服器、網通及遊戲機等散熱零組件之現有市佔之外，將積極開拓既有產品線之潛在客戶、新產品應用領域之業務開發等。

### (三)重要之產銷政策

1. 生產方面：因為散熱產品的產業特性為標準件少、設變頻繁且下單急促，故本公司嚴格管理庫存及降低庫存量，並提高存貨週轉能力。此外，積極投入自動化生產設備，降低人力需求，並提升生產品質和製程簡化改善，設計共用性材料，以有效降低成本，進而提供更具競爭力的價格。
2. 銷售方面：除深耕既有國內外市場佔有率外，視市場供需情形，逐步增加熱板產能投資。另加強海外行銷佈局，建立代理銷售管道積極開拓國際市場。

## 三、未來公司發展策略

- (一)因應現今市場潮流規畫更深廣之經營目標，並全面展開行動計畫，積極追蹤執行成效並機動策略調整。
- (二)運用集團資源與良好並深遠之客戶關係，擴大產品服務範圍與產業類別，取得各產品線在同業間之相對堅實位置。
- (三)持續提升研發技術質量與能量，與客戶共同分享研發成果與營收成長之績效。
- (四)持續提升高度的產能運用效率及自動化生產製程，以滿足未來市場需求。
- (五)不斷強化 ESG(環境(E)、社會(S)、治理(G))永續報導等重要議題並投入資源，全面積極朝金管會頒佈之永續發展路徑及溫室氣體盤查與查證時程方向前進。持續關注產業之環保政策，節能、減少碳排放、營造友善環境與勞動條件等，善盡社會責任。

#### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

公司面對外部市場競爭、證券主管機關頒布的新法令、國內外環保法規，以及全球經濟環境變化，均影響公司營運績效及成果甚深。近年關於 ESG 永續發展，已然成為全球各區域都非常重視的議題，亦是本公司長期致力及關注的目標。我司服務之合作客戶均為國際知名大廠，故持續與客戶齊步前進永續發展，方能走得更長更遠。面對近年來全球地緣政治安全變動風險與日俱增，全球產業鏈分佈及市場供需變化與產品價格競爭等，我司將隨時保持競爭力並與時俱進，以面對全球化浪潮下之各種挑戰。

最後 敬祝

身體健康 闔家平安

董事長：永井 淳一



執行長：永井 淳一



會計主管：陳美華

